

株主通信

平成20年度（第90期）第2四半期連結累計期間
（平成20年4月1日から9月30日まで）

大林秀仁社長インタビュー

より高い付加価値を提供し、優位性を発揮する

—平成20年度 第2四半期連結累計期間の業績概要と今後の戦略—

ハイテク・ソリューション事業における グローバルトップを目指します

日立ハイテクノロジーズは、あらゆるステークホルダーから「信頼」される企業を目指し、ハイテク・ソリューションによる「価値創造」を基本とした事業活動を通じ、社会の進歩発展に貢献します。あわせて、当社は「公正かつ透明」で信頼される経営を行い、成長し続けていくとともに、「環境との調和」を大切にし、情熱と誇りを持ち、社会的責任を全うする企業市民として豊かな社会の実現に尽力します。

目次

株主の皆様へ.....01	連結財務ハイライト.....10
大林秀仁社長インタビュー	連結貸借対照表.....12
より高い付加価値を提供し、優位性を発揮する	連結損益計算書、連結キャッシュ・フロー計算書.....13
—平成20年度 第2四半期連結累計期間の業績概要と今後の戦略—02	会社の概要.....14
事業概況 [平成20年度 第2四半期連結累計期間]04	ネットワーク.....15
事業のご紹介.....06	株式の状況.....16
CSR活動のご紹介.....08	株主メモ.....17
会計方針(収益認識基準)の変更について.....09	

株主の皆様へ

株主の皆様には、ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

日ごろのご支援とご理解に深く感謝申し上げますとともに、平成20年度(第90期)第2四半期連結累計期間(平成20年4月1日から9月30日まで)の概況をご報告申し上げます。

当社は、「ハイテク・ソリューション事業におけるグローバルトップを目指す」という企業ビジョンのもと、最先端技術を駆使して新製品を開発する設計・製造機能と、最適ソリューションを提供する商社機能を融合させ、そのシナジー効果をさらに追求する価値創造型企業として、信頼性の高い製品・サービスを世界中のお客様に提供しています。

当第2四半期連結累計期間の経営環境は、メモリーメーカーを中心とした半導体設備投資の凍結・延期に加え、原油・原材料の高騰、さらに金融危機に陥った米国経済の減速などにより、非常に厳しいものとなりました。

また、当第1四半期連結会計期間より、半導体製造装置、液晶関連製造装置など、出荷後に据付作業を要する製品の収益認識基準を出荷基準から据付完了基準に変更いたしました。

こうした中、当第2四半期連結累計期間における業績は、売上高423,361百万円、営業利益12,557百万円、経常利益13,908百万円、四半期純利益7,564百万円となりました。

配当金につきましては、株主の皆様に対する利益の還元と内部留保とのバランスを考慮し、1株当たりの中間配当金を15円00銭とすることといたしました。

当社は、企業の社会的責任を強く意識した経営を行い、ステークホルダーの皆様からの信頼の獲得と、事業活動を通じた社会の進歩、発展への寄与に努めてまいります。今後とも、変わらぬご支援とご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

平成20年11月

代表執行役 執行役社長兼取締役

大林 秀仁





大林秀仁社長インタビュー

より高い付加価値を提供し、 優位性を発揮する

—平成20年度 第2四半期連結累計期間の業績概要と今後の戦略—

執行役社長 大林 秀仁

QUESTION

平成20年度 第2四半期連結累計期間の業績についてお聞かせください。

電子デバイスシステム事業のうち、主力の半導体製造装置は、半導体、特にメモリー価格の下落により、デバイスメーカーの設備投資意欲が減退し、日を追うごとに状況が悪化してきました。しかしながら、ライフサイエンス事業では、引き続き欧米市場向け生化学・免疫自動分析システムが好調を維持、液晶関連製造装置や先端産業部材事業も健闘し、売上高は423,361百万円、営業利益は12,557百万円と、業績予想よりも売上高で2%、営業利益では43%上回る結果となりました。電子デバイスシステムなどの市場変動リスクの高い事業だけでなく、ライフサイエンスといった比較的安定した事業を持つ当社の強みが発揮されたと考えています。

QUESTION

平成20年度の見通しについてお聞かせください。

当社の第2四半期連結累計期間の業績は業績予想を上回るものとなりましたが、米国経済はサブプライム・ローン問題に端を発する金融不安の影響を受けてリセッション入りが懸念され、その影響が欧州や高成長を続けてきた中国などにも波及することが予想されます。また、半導体メモリー市場の長期低迷や液晶パネルの生産調整、円高など、エレクトロニクス業界全般が減速しており、当社を取り巻く経営環境は一段と厳しい状況が続くものと予測しています。このような状況下ではありますが、引き続き業績目標の達成に邁進していきます。

世界経済に逆風の吹き荒れる今こそ、商社を母体としてグローバルに営業・生産拠点をもち、かつメーカーとしての高い技術力を備えている当社の強みを生かして、競合他社への優位性を発揮するチャンスであると考えています。経済の動向を注意深く見定めながら、当社の持つネットワーク、マーケティング力を駆使してエマーシングを含めた市場の動きを敏感にとらえ、営業・サービス、技術開発力をもって、お客様のニーズに素早くお応えし、高い付加価値を提供するよう努めてまいります。

ハイテク産業は今後も成長が見込まれます。このような時こそ、環境やIT、健康など、次世代の産業発展に向けた新事業の立ち上げに注力していきます。

QUESTION

今後の経営課題と施策について教えてください。

私が平成19年4月に社長に就任した際、刻々と変化する経営環境に即応するため、「スピードと現場重視の経営」をスローガンとして掲げました。常に時代の潮流を見極めて、顧客第一主義と徹底的なマーケティング活動に基づくスピーディーかつ戦略的な製品開発を行っていきます。長期的な視点を堅持し、将来の成長を担う最先端技術の研究開発も継続的に行っていきます。そのうえで、次に示す三つの重点施策を推し進めていきます。

一つ目は、「商事部門(チップマウンタなど自社製品を除く情報エレクトロニクス、先端産業部材事業)の改革」です。従来の「仕入・販売」中心のビジネスモデルから、付加価値提供型のビジネスモデルへの転換に力を入れていきます。自社製品部門と商事部門の垣根を越えたシナジー効果、ハードとソフトを融合したソリューションなど、当社の強みを発揮できる事業を強化していきます。

二つ目は、「グローバル化の推進」です。現在の当社の売上高構成比率は国内と海外がほぼ半々ですが、長期的視野にもとづき成長を加速するため、さらに海外売上高比率を引き上げます。海外売上高に輸入品国内販売高を合算した海外取引高比率65%達成を目標にしています。

三つ目は「連結経営の深化」です。グループ各社が有する開発・製造・販売・サービスなどの機能を強化するとともに、各社のリソース配置を最適化するなど、グループ企業価値の最大化を図っていきます。

QUESTION

株主への利益還元についてお聞かせください。

当社は財務体質と経営基盤の強化を図りながら、株主の皆様に対して適正な利益還元を行うことを基本方針としています。具体的には、開発や経営効率の向上を図るための投資などを考慮しつつ、安定的な配当に努めています。今年度は1株当たりの中間配当金は15円00銭とし、年間配当金は30円00銭とする予定です。

資本政策として、次世代に向けた研究開発や設備投資、コアビジネスを補完するためのM&Aなどに備えた内部留保にも努める必要があります。これらのバランスを考慮したうえで、株主の皆様のご支援に報いる最適な水準と方法を検討していきたいと考えています。

QUESTION

株主の皆様へメッセージをお願いします。

当社は、エレクトロニクス商社を母体として長年培ってきたグローバルな営業・サービス力と、多くのトップシェア製品を世に送り出した技術開発力、世界に誇る日立の研究開発陣との強固な連携という、他に例を見ないリソースを有しています。これを生かし、「スピードと現場重視の経営」を通じて、企業ビジョンである「ハイテク・ソリューション事業におけるグローバルトップ」の実現を図るべく、積極的に事業を展開していきます。

株主の皆様をはじめ、すべてのステークホルダーの皆様のご期待にお応えするよう、全社一丸となり、企業価値向上に取り組んでまいります。株主の皆様におかれましては、引き続き、ご支援、ご愛顧をお願い申し上げます。

事業概況

[平成20年度 第2四半期連結累計期間]

電子デバイスシステム

[主な製品]

エッチング装置などの半導体製造装置、測長SEM・外観検査装置などの半導体製造工程検査装置、電子顕微鏡、液晶関連製造装置、ハードディスク関連製造装置、社会システム関連装置



大型ガラス基板露光装置
LE0200SD

半導体製造装置は、主力製品の測長SEMがアジア地区を中心としたメモリー、ロジックメーカーの設備投資延期などにより、大幅に減少しました。またエッチング装置も、厳しい市場環境の影響を受け、国内・海外ともに減少しました。

液晶関連製造装置は、中国・台湾向け露光装置は増加しましたが、実装装置が減少したため、全体では大幅に減少しました。

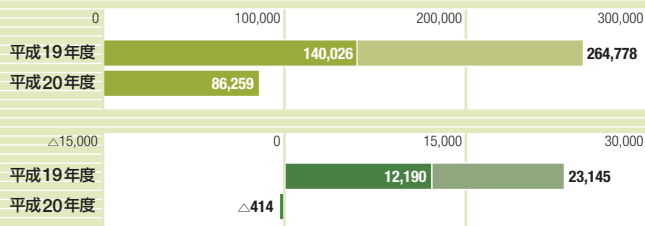
なお、当セグメントでは、会計方針（収益認識基準）の変更に伴い、売上高22,901百万円、営業利益4,892百万円が減少しました。

以上の結果、当セグメントの売上高は86,259百万円、営業損失414百万円となりました。

連結売上高・連結営業利益の推移

(百万円)

連結売上高 ■ (上半期) ■ (下半期)
連結営業利益 ■ (上半期) ■ (下半期)



ライフサイエンス

[主な製品]

質量分析計・核磁気共鳴装置・分光光度計・クロマトグラフ・遠心機などの各種分析計測機器、バイオ関連機器、医用分析装置



生化学・免疫自動分析システム
cobas6000

医用分析装置は、欧州向けの生化学・免疫分析システム、検体前処理システムの販売が引き続き好調に伸長したことにより、大幅に増加しました。

バイオ関連機器については、顧客の投資抑制傾向の強まりなどにより、DNAシーケンサ、液体クロマトグラフは横這いとなりました。

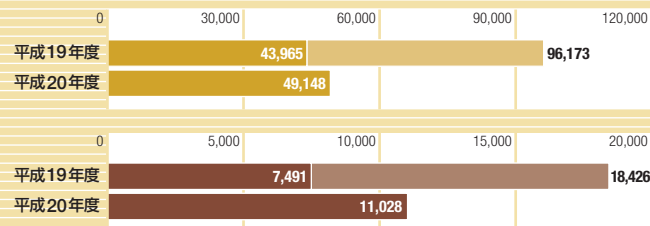
なお、当セグメントでは、会計方針（収益認識基準）の変更に伴い、売上高29百万円、営業利益8百万円が減少しました。

以上の結果、当セグメントの売上高は49,148百万円、営業利益11,028百万円となりました。

連結売上高・連結営業利益の推移

(百万円)

連結売上高 ■ (上半期) ■ (下半期)
連結営業利益 ■ (上半期) ■ (下半期)



情報エレクトロニクス

[主な製品]

計装機器および関連システム、電子部品実装システム、自動組立システム、自動車用各種計測・検査機器、発・変電設備、研究試験設備、コンピュータシステム、プリンタ・磁気記憶装置などの周辺機器、半導体・集積回路、液晶表示装置、その他各種電子部品、民生用情報機器



チップマウンタ GXH-3

チップマウンタは、大手EMS (Electronic Manufacturing Service) の設備投資の見直し・凍結により市場環境が悪化したため、大幅に減少しました。

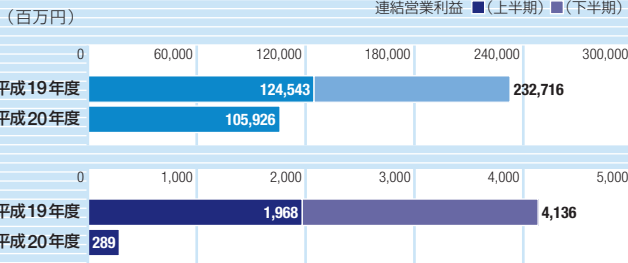
情報通信関連では、米国向け携帯電話が堅調に推移しました。

アジア市場では携帯電話用のバッテリーは堅調に推移しましたが、半導体は大幅に減少しました。

なお、当セグメントでは、会計方針 (収益認識基準) の変更に伴い、売上高792百万円、営業利益104百万円が減少しました。

以上の結果、当セグメントの売上高は105,926百万円、営業利益289百万円となりました。

連結売上高・連結営業利益の推移



先端産業部材

[主な製品]

鉄鋼製品、非鉄金属製品、基板材料、合成樹脂、電子材料、光通信部材、光ストレージ部材、その他化成品、建設資材、自動車関連部品、石油・石油製品・ガス



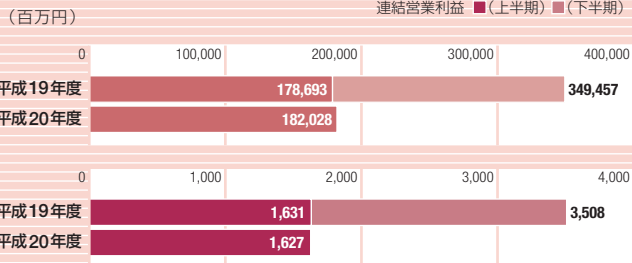
太陽電池

シリコンウエーハは、半導体需要の減少により横這いとなりました。液晶関連部材はテレビ、携帯電話用が大幅に増加しました。

工業材料は、素材価格の上昇に加え、太陽電池部材が増加しましたが、プリンタ関連部材が大幅に減少したため、横這いとなりました。

以上の結果、当セグメントの売上高は182,028百万円、営業利益1,627百万円となりました。

連結売上高・連結営業利益の推移



事業のご紹介

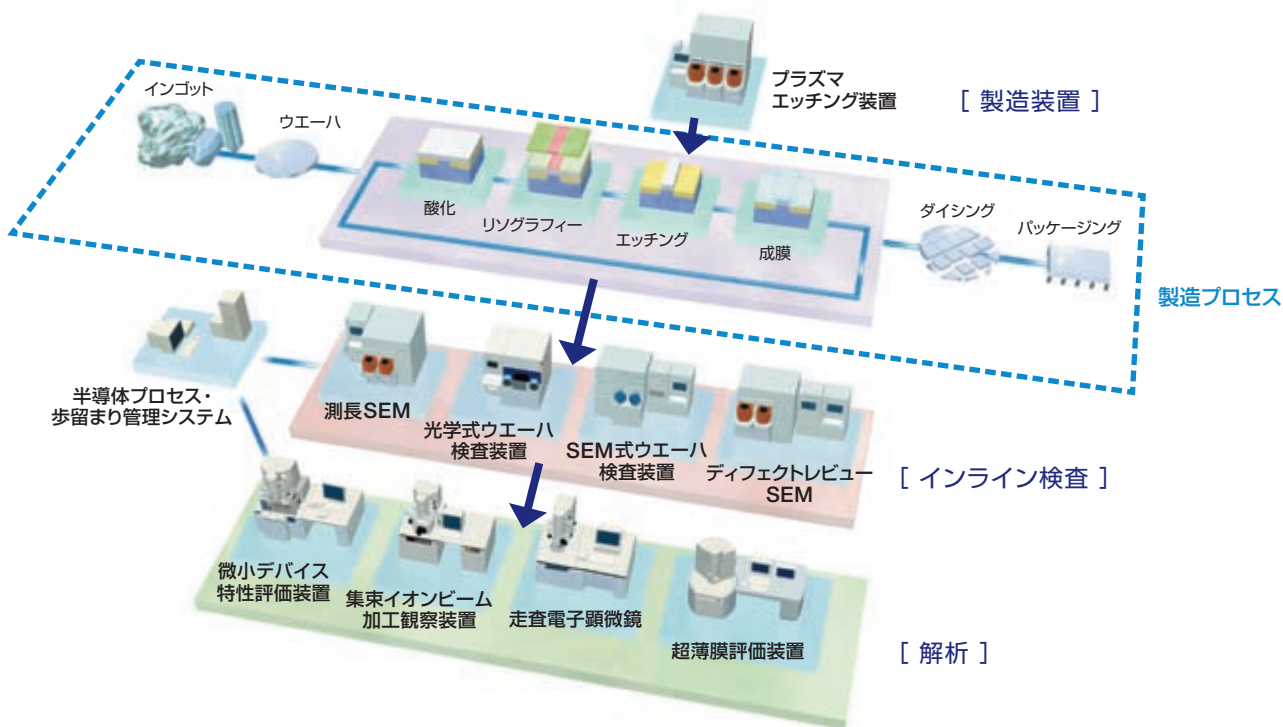
半導体製造装置

マイコンやシステムLSI、フラッシュメモリーなどに代表される半導体は、家庭内ではすでに、洗濯機やエアコンからTV、ゲーム機、PCまで、また情報・通信・産業分野ではスーパーコンピュータから電子マネー、自動車、工場の自動化まで、幅広く使われています。私たちの身の周りにあるさまざまな製品は半導体なしには機能しないほど、現代生活には欠かせないものとなっています。

半導体の回路パターンは、年々ほぼ一定の割合で「微細化」しており、現在最先端の研究では32nm（ナノメートル、1nmは10億分の1メートル）以降の製造プロセスの開発が進められています。半導体トランジスタなどの素子の微細化によって、ICやLSIなど一つの半導体デバイス内により多くの機能を盛り込むことが可能になります。これにより、半導体を使用した製品を高機能化、小型化することができます。

日立ハイテクでは、この微細化を支える半導体製造装置および半導体の生産性や信頼性を高める検査・計測・解析装置などの技術開発と供給に注力し、半導体産業の進化・革新に貢献しています。

半導体製造プロセスと日立ハイテクの製品群



製品のご紹介

ハードマスク/
シリコン用
エッチング装置
M-8170XT



エッチング装置は、半導体製造プロセスで使われる製造装置の一つです。半導体基板上に塗布されたフォトリソと呼ばれる感光性の樹脂に露光装置を使って回路パターンを感光させ、これを現像することで基板上に回路パターンが転写されます。このパターンをマスクとして、配線などの電気回路を基板上に食刻加工するのがエッチング装置です。

日立ハイテクのエッチング装置は、半導体プロセスにおいて最先端の微細加工に対応するとともに、歩留まりや生産性の向上を実現させています。世界中のお客様から高い支持をいただいております、ますます成長が期待されている製品です。

高分解能FEB測長装置(測長SEM)は、ウエーハ上の微細な回路パターンの線幅などの寸法を計測するために専用設計されたSEM(Scanning Electron Microscope: 走査電子顕微鏡)です。

日立ハイテクの測長SEMは、最先端の微細パターンに対応した計測精度と処理能力における高い信頼性を実現し、世界中のお客様から圧倒的な支持(当社推定世界シェア約80%)をいただいております。

また、半導体回路設計データを活用したシステム「DesignGauge®」の導入により、難易度の高い微細パターン製造の検証作業において、大幅な効率向上を図ることを実現しました。

設計データ応用
計測システム
DesignGauge®



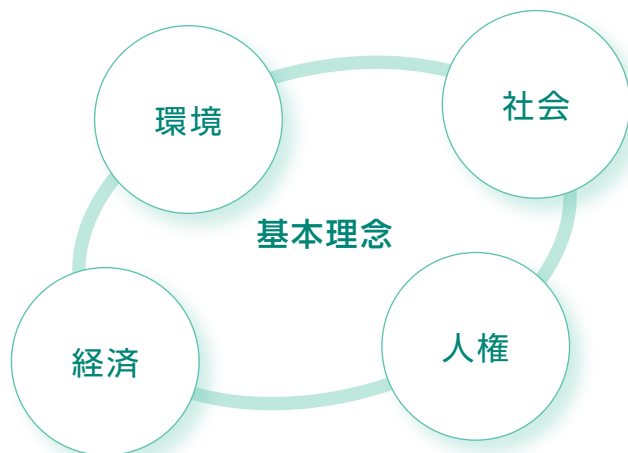
高分解能
FEB測長装置
CG4000



CSR活動のご紹介

— 環境社会貢献活動 —

日立ハイテクノロジーズグループのCSRとは、「ハイテク・ソリューションによる「価値創造」を基本とした事業活動を通じ、社会の進歩発展に貢献する」という『基本理念』を全社員が共有し、企業活動の中で実践していくことです。この基本理念の実践に際しては、環境、社会、人権、経済等の側面を考慮し企業の社会的責任を果たしていきます。



日立ハイテクグループでは、事業活動や提供する製品をとおして地球環境の保全へ貢献するよう努めるとともに、植林や地域清掃などの環境社会貢献活動にも積極的に取り組んでいます。

この活動の一環として、地球温暖化防止への貢献を目的に、植林活動に取り組んでいます。

平成17年4月より、林野庁の「法人の森林分収造林制度」を活用し、茨城県石岡市(旧八郷町)にある国有林の一角に2.3ヘクタールの土地を借り受け、「日立ハイテクやさとの森」としてヒノキなどの苗木

5,600本を植樹しました。苗木の成長のためには、植樹後も約60年間にわたり、雑草を除く下草刈りや間伐を行うなどの定期的な手入れが必要となるため、平成18年からは毎年社員有志が下草刈りを実施しています。

平成20年度は、5月に新入社員81人が、6月に社



会計方針(収益認識基準)の変更について

第1四半期連結会計期間より、半導体製造装置、液晶関連製造装置など、出荷後に据付作業を要する製品の収益認識基準を出荷基準から据付完了基準に変更しています。

この変更は、微細加工技術の進展による半導体製造装置の高性能化・液晶関連製造装置の大型化などにより出荷から据付完了にいたる期間が長期となる自社製品の収益に占める割合が増加してきた

こと、また、システム構築などにより据付作業の完了に関するデータの把握が可能となったことから、収益の実態をより適切に決算に反映させるために行うものです。

なお、第2四半期連結累計期間における従来基準との比較は以下のとおりです。

(単位:百万円)

		第2四半期連結累計期間		会計方針の変更による 影響額(A-B)	(ご参考)平成19年9月 中間期
		変更後(A)	変更前(B)		
電子デバイスシステム	売上高	86,259	109,160	△22,901	140,026
	営業利益	△414	4,478	△4,892	12,190
ライフサイエンス	売上高	49,148	49,176	△29	43,965
	営業利益	11,028	11,035	△8	7,491
情報エレクトロニクス	売上高	105,926	106,718	△792	124,543
	営業利益	289	393	△104	1,968
先端産業部材	売上高	182,028	182,028	-	178,693
	営業利益	1,627	1,627	-	1,631
消去又は全社	営業利益	28	28	-	△20
連結	売上高	423,361	447,083	△23,722	487,227
	営業利益	12,557	17,561	△5,004	23,259

—「やさとの森」平成19年度分の環境保全効果(関東森林管理局調べ)—

- (1) 二酸化炭素の吸収・貯蔵・・・12.7t/年:40人分の年間CO₂排出量
- (2) 水源かん養(洪水や濁水の緩和・水質の浄化)・・・206m³/年:2ℓペットボトル10万3千本分
- (3) 土砂流出防止・・・5.0m³/年:10tトラック1台分

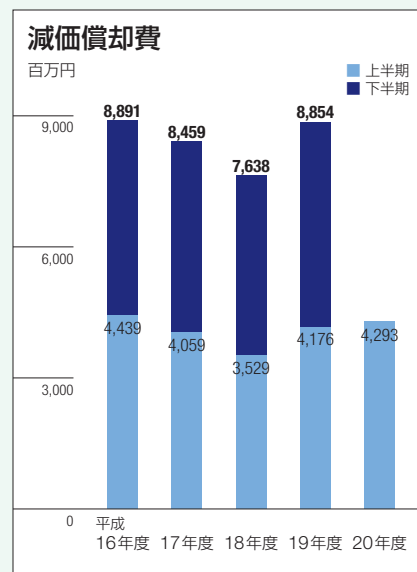
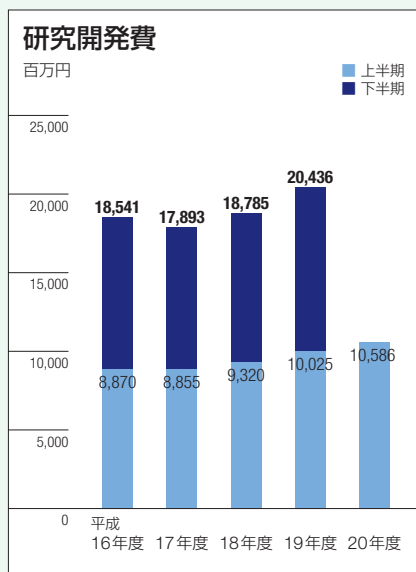
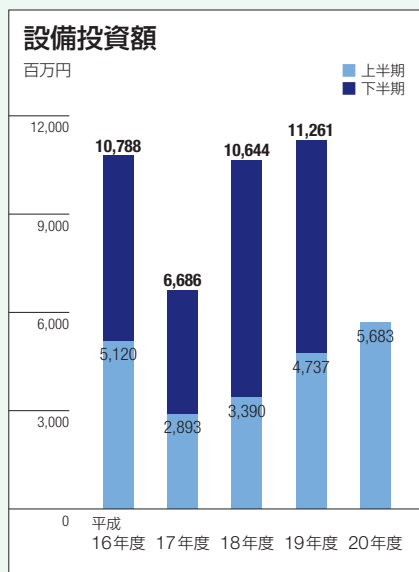
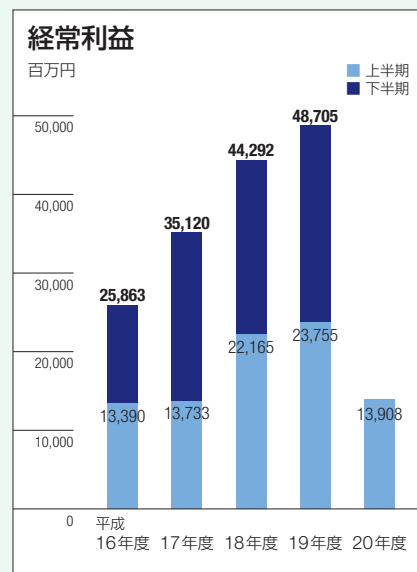
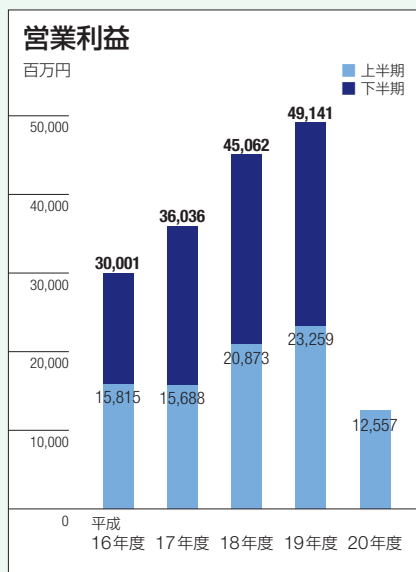
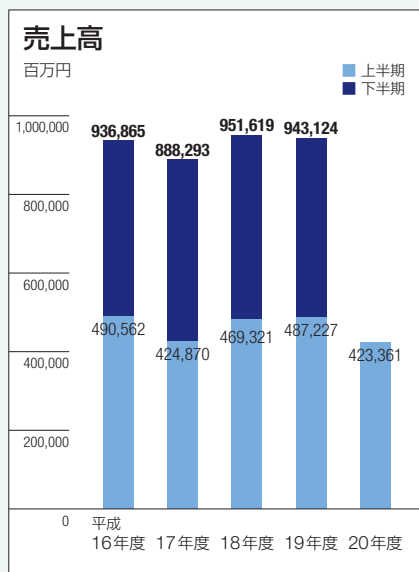
員とその家族91人が参加し、森林管理署と森林組合の協力の下、雑草を刈り取るとともに、森林管理署による環境保全についての講義、環境クイズを行い、森林保全の大切さについて学びました。また、グループ会社である株式会社日立ハイテクフィールドディングでは、茨城県日立市、三重県いなべ市の

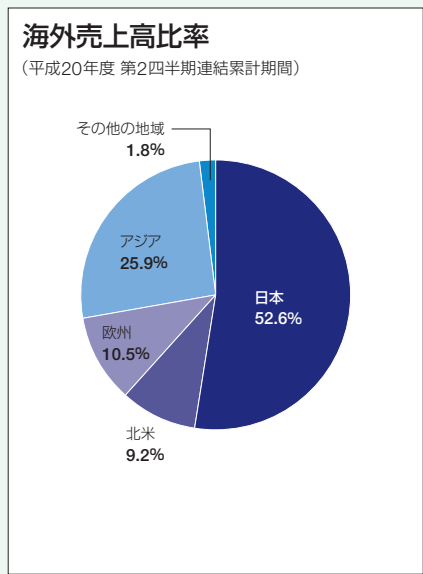
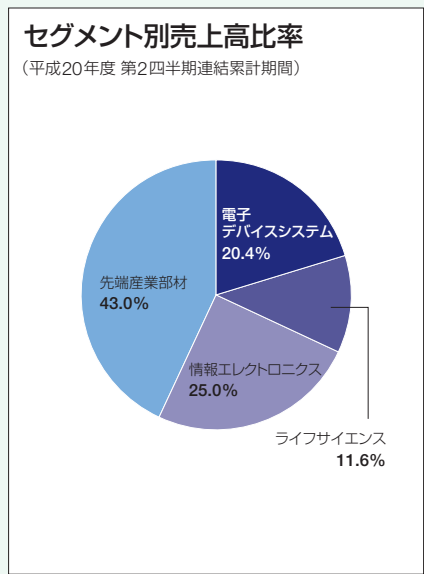
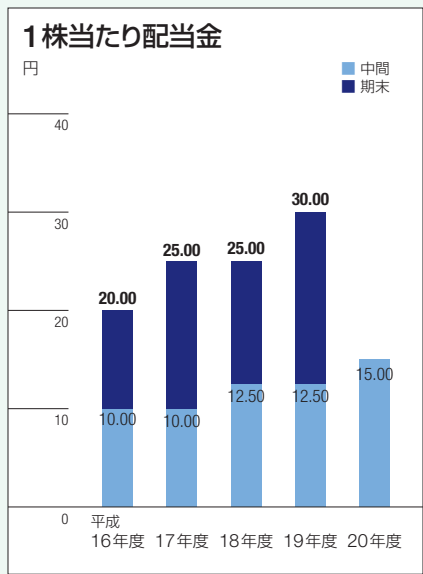
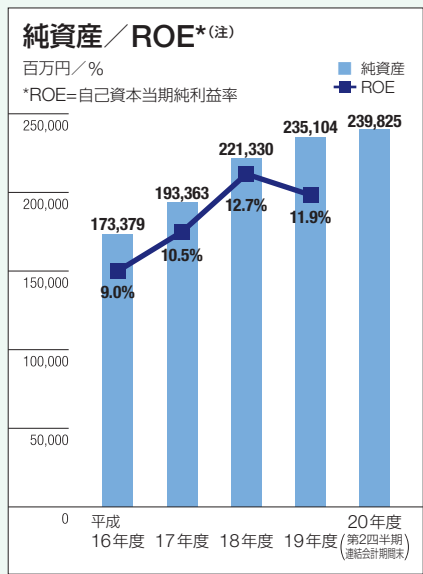
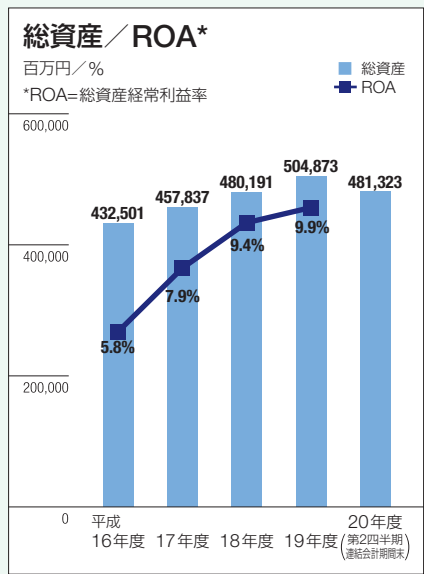
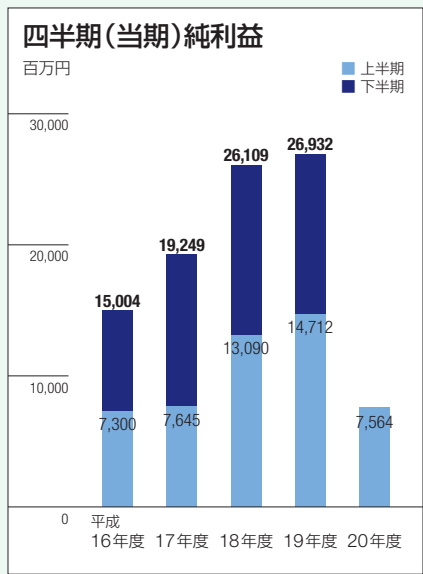
国有林にてヒノキなどを植樹し、毎年下草刈りを行っています。今後も環境に配慮した企業市民として、継続的に森を育て、地球温暖化防止に貢献してまいります。



下草刈りの様子
(平成20年6月)

連結財務ハイライト





(注)平成18年度より、貸借対照表の純資産の部の表示を定めた会計基準等を適用しております。

連結貸借対照表

(単位:百万円)

科目	当第2四半期 連結会計期間末 (平成20年9月30日)	前連結会計年度末 (平成20年3月31日)
資産の部		
1 流動資産	389,649	411,637
現金及び預金	27,721	25,819
受取手形及び売掛金	215,111	247,409
有価証券	107	1,129
商品及び製品	32,511	29,539
原材料	3,181	4,650
仕掛品	46,213	32,880
関係会社預け金	38,233	45,957
その他	29,696	27,630
貸倒引当金	△3,123	△3,378
固定資産	91,673	93,236
有形固定資産	59,404	58,692
無形固定資産	4,175	3,847
のれん	325	292
その他	3,850	3,554
投資その他の資産	28,094	30,698
その他	29,109	31,763
貸倒引当金	△1,015	△1,065
資産合計	481,323	504,873

科目	当第2四半期 連結会計期間末 (平成20年9月30日)	前連結会計年度末 (平成20年3月31日)
負債の部		
2 流動負債	214,533	242,813
支払手形及び買掛金	149,388	178,134
未払法人税等	6,790	8,918
製品保証等引当金	1,979	2,154
その他	56,375	53,607
固定負債	26,965	26,956
退職給付引当金	25,991	25,796
役員退職慰労引当金	220	885
その他	753	275
負債合計	241,498	269,769
純資産の部		
株主資本	237,419	232,269
資本金	7,938	7,938
資本剰余金	35,745	35,745
利益剰余金	194,049	188,892
自己株式	△313	△306
評価・換算差額等	2,173	2,624
その他有価証券評価差額金	3,548	4,365
繰延ヘッジ損益	173	156
為替換算調整勘定	△1,548	△1,897
少数株主持分	233	211
3 純資産合計	239,825	235,104
負債及び純資産合計	481,323	504,873

財務諸表の記載金額は百万円未満を四捨五入して表示しております。

※ 第1四半期連結会計期間より、半導体製造装置、液晶関連製造装置など、出荷後に据付作業を要する製品の収益認識基準を出荷基準から据付完了基準に変更しています。変更による業績への影響額などの詳細につきましては9ページをご参照ください。

連結損益計算書

(単位:百万円)

科目	当第2四半期 連結累計期間	(ご参考)平成19年 9月中間期
	(平成20年4月1日から 平成20年9月30日まで)	(平成19年4月1日から 平成19年9月30日まで)
売上高	423,361	487,227
売上原価	364,918	413,367
売上総利益	58,443	73,860
販売費及び一般管理費	45,885	50,601
営業利益	12,557	23,259
営業外収益	1,722	1,253
営業外費用	371	758
経常利益	13,908	23,755
特別利益	767	691
特別損失	570	306
税金等調整前四半期(中間)純利益	14,105	24,140
法人税、住民税及び事業税	7,467	8,412
法人税等調整額	△959	823
少数株主利益	33	193
四半期(中間)純利益	7,564	14,712

連結貸借対照表／対前連結会計年度末比較増減

1 流動資産

流動資産が220億円減少しました。主に受取手形及び売掛金が減少したことなどによるものです。

2 流動負債

流動負債が283億円減少しました。主に支払手形及び買掛金が減少したことなどによるものです。

3 純資産

純資産が47億円増加しました。主に利益剰余金が増加したことなどによるものです。

連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)

科目	当第2四半期 連結累計期間	(ご参考)平成19年 9月中間期
	(平成20年4月1日から 平成20年9月30日まで)	(平成19年4月1日から 平成19年9月30日まで)
4 営業活動による キャッシュ・フロー	316	16,052
5 投資活動による キャッシュ・フロー	△1,953	△3,791
6 財務活動による キャッシュ・フロー	△7,501	△1,963
現金及び 現金同等物に係る換算差額	△47	△86
現金及び 現金同等物の増減額	△9,185	10,212
現金及び 現金同等物の期首残高	77,853	59,267
現金及び現金同等物の 四半期末(中間期末)残高	68,668	69,479

(注) 連結キャッシュ・フロー計算書の△は、現金及び現金同等物の流出を示しております。

当第2四半期連結累計期間における 連結キャッシュ・フローの状況

4 営業活動によるキャッシュ・フロー

営業活動によるキャッシュ・フローは3億円の収入となりました。主に、税金等調整前四半期純利益141億円、売上債権の減少額321億円がそれぞれキャッシュ・フローのプラスとなつた一方、たな卸資産の増加額164億円、仕入債務の減少額285億円がそれぞれキャッシュ・フローのマイナスとなつたためです。

5 投資活動によるキャッシュ・フロー

投資活動によるキャッシュ・フローは20億円の支出となりました。主に、有形・無形固定資産の取得による支出65億円がキャッシュ・フローのマイナスとなつた一方、有価証券及び投資有価証券の売却による収入28億円、有形・無形固定資産の売却による収入17億円がそれぞれキャッシュ・フローのプラスとなつたためです。

6 財務活動によるキャッシュ・フロー

財務活動によるキャッシュ・フローは75億円の支出となりました。主に、配当金の支払額24億円、海外子会社での少数株主からの株式買取による支出51億円によるものです。

会社の概要 (平成20年9月30日現在)

- 商 号 株式会社日立ハイテクノロジーズ
- 本社所在地 東京都港区西新橋一丁目24番14号
- 設立年月日 昭和22年4月12日
- 資 本 金 7,938,480,525円
- 従 業 員 連結 10,658名
単独 4,677名
- 役 員 **【取締役】**

取締役会長 社外取締役	崎山 忠道
取 締 役	大林 秀仁
取 締 役	中野 和助
取 締 役	金内 寛
社外取締役	内田 晴康
社外取締役	宗岡 広太郎

【執行役】

代表執行役 執行役社長	大林 秀仁
代表執行役 執行役専務	中野 和助
代表執行役 執行役専務	川崎 義直
執行役専務	宮内 真澄
執行役常務	和田 憲也
執行役常務	飯塚 茂

執行役常務	増山 正穂
執行役常務	林 充宏
執行役常務	仙石 俊男
執行役常務	大木 博
執行役常務	水野 克美
執行役常務	中村 修
執行役常務	風巻 成典

執 行 役	安藤 力
執 行 役	田地 新一
執 行 役	小林 紀雄
執 行 役	松坂 尚
執 行 役	宮崎 正啓
執 行 役	西田 守宏
執 行 役	光用 豊
執 行 役	加藤 重和



ネットワーク (平成20年9月30日現在)

■ 当社グループの主要な営業所および工場

【国内営業所】

本社	東京都港区
西日本支社	大阪府大阪市
・関西支店	大阪府大阪市
・中国支店	広島県広島市
・九州支店	福岡県福岡市
関東支社	東京都港区
・茨城支店	茨城県日立市
・筑波支店	茨城県土浦市
・中部支店	愛知県名古屋市
・東北支店	宮城県仙台市
・北海道支店	北海道札幌市

【工場】

那珂事業所	茨城県ひたちなか市
笠戸事業所	山口県下松市
湘南事業所	神奈川県足柄上郡中井町
埼玉事業所	埼玉県児玉郡上里町

【国内グループ会社(販売5社、製造・サービス5社)】

主要な子会社

㈱日立ハイテクトレーディング	東京都港区
㈱日立ハイテックマテリアルズ	東京都港区
㈱日立ハイテックフィールドینگ	東京都新宿区
㈱日立ハイテックコントロールシステムズ	茨城県水戸市
㈱日立ハイテックマニファクチャ&サービス	茨城県ひたちなか市
㈱日立ハイテックインストルメンツ	埼玉県熊谷市

【海外グループ会社(米州地域3社、欧州地域3社、アジア地域13社)】

主要な子会社

日立ハイテクノロジーズアメリカ会社	アメリカ合衆国
日立ハイテクノロジーズヨーロッパ会社	ドイツ連邦共和国
日立ハイテクノロジーズシンガポール会社	シンガポール共和国
日立ハイテクノロジーズ香港会社	中華人民共和国
日立ハイテクノロジーズ台湾会社	台湾

■ 支店、出張所、現地法人
■ 生産拠点

■ 本社、支社、支店、営業所、出張所、事務所
■ 事業所

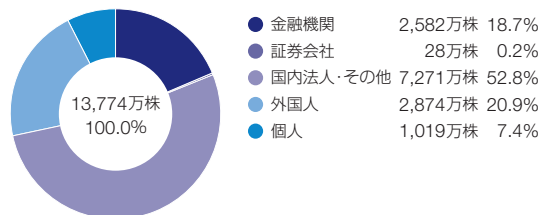
株式の状況 (平成20年9月30日現在)

■ 発行済株式総数 137,738,730株

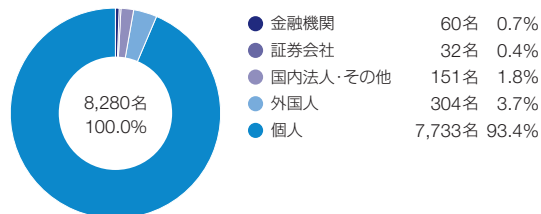
■ 株主数 8,280名

■ 株式分布状況

所有者別株式分布状況(持株数)



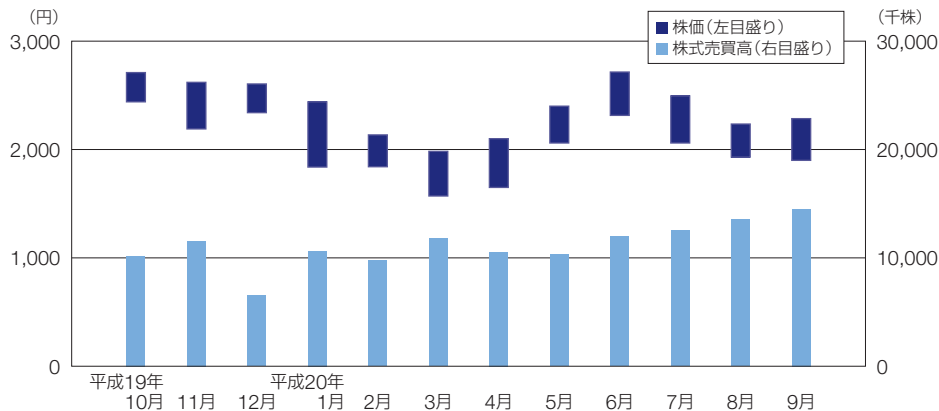
所有者別株式分布状況(株主数)



■ 大株主

株主名	持株数	持株比率
株式会社日立製作所	70,807,382株	51.41%
日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (信託口)	7,126,700株	5.17%
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 (信託口)	5,880,900株	4.27%
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 (信託口4G)	4,094,900株	2.97%
野村信託銀行株式会社(投信口)	1,887,300株	1.37%
日立ハイテクノロジーズ社員持株会	1,853,036株	1.35%
ザ チェース マンハッタン バンク エヌエイ ロンドン エス エル オムニバス アカウント	1,677,806株	1.22%
ハイアット	1,350,000株	0.98%
資産管理サービス信託銀行株式会社 (証券投資信託口)	1,186,900株	0.86%
マサ ジャパニーズ エクイティ	1,162,000株	0.84%

■ 株価と株式売買高の推移



株主メモ

- 事業年度 毎年4月1日から翌年3月31日まで
 - 定時株主総会 毎年6月
 - 上場証券取引所 東京・大阪証券取引所（市場第一部）
 - 公告掲載新聞 日本経済新聞
 - 剰余金の配当の受領株主確定日 毎年3月末日および9月末日
 - 株主名簿管理人 東京証券代行株式会社
 - 同上事務取扱場所 〒100-0004
東京都千代田区大手町二丁目6番2号
（日本ビル4階）
- [郵便物送付先・連絡先] 〒168-0063
東京都杉並区和泉二丁目7番1号
東京証券代行株式会社 代行本部
- お問合せ先 ☎ 0120-49-7009
 - 事務取次所 中央三井信託銀行株式会社本店及び
全国各支店

I 株券の電子化について

平成21年1月5日から上場会社は株券電子化制度へ移行し、お手持の当社株券は無効となり、すべての株主様の権利は電子的に証券会社等の口座で管理されます。これに伴い、以下のとおり各種手続のお申出先が変更となりますので、ご注意ください。

1. 未支払配当金のお支払い
株主名簿管理人である東京証券代行株式会社にお申し出ください。
2. 住所変更・単元未満株式の買取、配当金受取方法の指定等
お取引の証券会社等にお申し出ください。
なお、株券電子化制度への移行までに証券会社等を通じて証券保管振替機構に株券を預託されなかった株主様の株式につきましては、当社が上記東京証券代行株式会社に口座（特別口座）を開いたしますので、こちらがお申出先になります。ただし、お申し出を受け付けることができるのは、口座開設予定日である平成21年1月26日からとなりますのでご了承ください。

II 株券の電子化移行日前後の各種ご請求のお取扱いについて

株券電子化移行日前後の単元未満株式の買取請求や、特別口座から一般口座への振替請求のお取扱いにつきましては、当社ウェブサイト「株主・投資家向け情報」の「よくあるご質問(FAQ)」をご覧ください。どうか、東京証券代行株式会社にお問い合わせください。

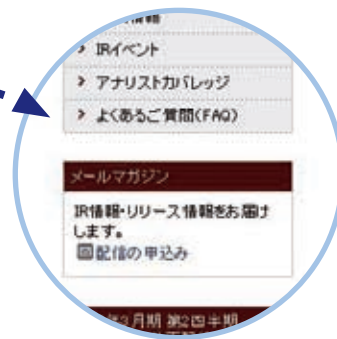
ご案内

当社ウェブサイト「株主・投資家向け情報」では、最新情報をご覧いただけます。また、株券電子化に伴う取扱いにつきましては「よくあるご質問(FAQ)」に掲載しております。

<http://www.hitachi-hitec.com/ir/index.html>



click!



メールマガジンの配信お申込みはこちらです

 株式会社日立ハイテクノロジーズ

〒105-8717 東京都港区西新橋一丁目24番14号

電話(03)3504-7111

<http://www.hitachi-hitec.com>



「大豆インキ」で印刷しています。